

天水华天科技股份有限公司

证券代码:002185 证券简称:华天科技
公告编号:2013-040

2013 半年度 报告摘要

1.重要提示
(1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2) 公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
姓名和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	常文斌		杨彬群
电话	0938-8631816		0938-8631990
传真	0938-8632016		0938-8632260
电子信箱	hwzq20006@163.com		zyp@hst.com

2.主要财务数据及股东变化
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,084,772,652.54	632,539,228.33	71.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,923,219.29	73,387,164.20	38.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	94,236,155.46	40,811,190.20	130.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,502,197.77	32,255,905.19	152.67%
基本每股收益(元/股)	0.1569	0.1129	38.97%
稀释每股收益(元/股)	0.1569	0.1129	38.97%
加权平均净资产收益率(%)	6.5%	4.96%	1.54%
总资产(元)	2,701,710,203.93	2,555,439,760.21	5.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,593,065,643.76	1,523,632,824.47	4.56%

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	34,566				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
天水华天科技股份有限公司	境内非国有法人	34.66	23,827,520	0	质押,46,000.00
杭州华冠电子有限公司	境内非国有法人	3.28	2,132,769	0	
中国民生银行-聚财成长内需增长股票型证券投资基金	其他	2.28	1,483,319	0	
宁波梅园汇丰投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	1.77	115,200.00	0	
中国民生银行-聚财成长内需增长开放式证券投资基金	其他	1.5%	9,732,206	0	
上海富利行“发展”股票型证券投资基金	其他	1.47%	9,550,120	0	
上海明耀文化律师事务所 普通通	境内非国有法人	1.45%	9,430,000	0	
中国银河证券股份有限公司-中国银河聚财证券投资基金(中国)	其他	1.16%	7,529,838	0	
中国工商银行-汇添富成长先锋混合型证券投资基金	其他	1.15%	7,459,904	0	
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	6,890,000	0	

上述大股东关系一致行动的情况: 公司实际控制人常文斌与常文斌系一致行动人的情况。
实际控制人常文斌持股情况(如有): 无

(3) 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
 适用 不适用
实际控制人报告期内变更
 适用 不适用

3.管理层讨论与分析
2013年上半年,在智能手机、平板电脑以及半导体照明等集成电路应用领域快速增长的带动下,我国集成电路市场需求旺盛,公司紧抓集成电路市场发展机遇,根据2013年所确定的经营指导思想以及年度经营目标和战略规划,通过各项工作的有效开展,公司实现了平稳较快发展,2013年1-6月份公司完成销售收入108,477.26万元,同比增长71.49%,实现净利润10,192.32万元,同比增长38.88%,截止到2013年6月30日,公司总资产为270,170.2万元,同比增长5.72%。

2013年1-6月份,公司继续实施了“集成电路高端封装测试产线技术改造”项目和“集成电路封装测试产线工艺升级技术改造”项目,通过项目的有效实施,公司的集成电路封装测试能力由80亿块增加到85亿块,2013年上半年,公司完成集成电路封装测试产能4.48亿块。

公司在持续扩大集成电路封装测试产能的同时,通过工艺优化和不断高制程制程能力以及节能环保等措施,有效的控制了公司的运营成本,使公司的经营业绩得到了显著提升,进一步加大了海内外市场的开拓力度,2013年上半年公司出口销售收入53,318.42万元,占公司销售收入的49.15%。

继续推进国家科技重大专项02专项、集成电路产业研究与开发专项等科技创新和科技研发项目的实施,使公司集成电路封装技术水平得到了有效的提高,科技创新能力进一步提升,BGA、FC、TSV等集成电路封装技术产业化生产产能逐步提高,公司产品竞争力得到进一步提升。

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯会计说明的情况说明
(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用

天水华天科技股份有限公司
法定代表人:肖胜利
二〇一三年八月三十日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2013-042
天水华天科技股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司
华天科技(西安)有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2013]109号文)核准,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月12日向公众公开发行了461万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额461,000万元,并于2013年8月28日在深交所上市,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为461,000,000.00元,扣除发行费用9,666,500.00元后的实际募集资金净额为451,333,500.00元,该募集资金已于2013年8月16日到达公司募集资金专项账户,募集资金到位情况业经毕华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕华验字[2013]第29A0002号《验资报告》。

按照公司公开发行可转换公司债券方案,募集资金投资项目“40纳米集成电路先进封装测试产业化项目”通过全资子公司华天科技(西安)有限公司实施(以下简称“西安公司”)。根据公司实际发行结果,公司拟使用募集资金15,000万元对西安公司进行增资,增加注册资本15,000万元,用于其进行“40纳米集成电路先进封装测试产业化项目”的建设。

2013年8月29日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司华天科技(西安)有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金15,000万元对华天科技(西安)有限公司进行增资,增加其注册资本15,000万元,用于其进行募集资金投资项目“40纳米集成电路先进封装测试产业化项目”的建设。

根据《公司章程》及公司《投资经营决策制度》的有关规定,本次对全资子公司华天科技的增资属公司董事会审批权限,无需经过股东大会批准。

一、增资基本情况
1. 增资公司基本情况
名称:华天科技(西安)有限公司
成立日期:2008年1月30日
注册资本:36,100.00万元
法定代表人:肖胜利
注册地址:西安经济技术开发区凤城五路105号
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:半导体、集成电路和半导体电子元器件设计、研发、生产、销售;货物及技术的进出口业务。(以上经营范围涉及国家专项专营规定的从其规定)。
本次增资前西安公司注册资本36,100.00万元;本次增资完成后注册资本将增至51,100万元,公司仍持有其100%股权。

2. 本次增资涉及的募集资金项目情况
(1) 项目名称:40纳米封装测试产线产业化项目
(2) 项目内容:本项目是在利用公司目前掌握的具有自主知识产权的40纳米智能芯片减薄/划片/上芯/压焊/覆膜技术、Flip-chip技术、电性检测技术、机械/板/锡焊/覆膜技术等集成电路先进封装测试技术基础上,进一步优化、完善制作工艺,使各系列封装产品的引线数、引线间距、引线角度、外形尺寸、封装精度等各项技术指标全部符合国际通用标准和满足各类电子产品要求,完成40纳米智能芯片的BGA、LGA、QFN、DFN等系列封装量产。项目建成后将形成年产封装BGA系列、LGA系列、QFN系列、DFN系列等集成电路先进封装产品2亿片的生产能力。

(3) 项目目标投资及实施主体:本项目目标投资1.62亿元,由西安公司负责实施,项目建设地点位于西安市凤城五路105号投资经济技术开发区内,本项目将利用现有厂房,无需新建。

(4) 项目投资估算:本项目总投资22,820万元,其中,固定资产投资21,162.89万元,铺底流动资金1,022.22万元。本次募集资金拟投入金额15,000万元。

(5) 项目经济效益测算
预计达产后销售收入约23,666万元,净利润约2,456万元。

三、本次增资项目的可行性分析
本次对西安公司的增资及实施主体,本项目目标投资1.62亿元,由西安公司负责实施,项目建设地点位于西安市凤城五路105号投资经济技术开发区内,本项目将利用现有厂房,无需新建。

(4) 项目投资估算:本项目总投资22,820万元,其中,固定资产投资21,162.89万元,铺底流动资金1,022.22万元。本次募集资金拟投入金额15,000万元。

(5) 项目经济效益测算
预计达产后销售收入约23,666万元,净利润约2,456万元。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及刊登于《证券时报》的2013-042号公司公告。特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一三年八月三十日

证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2013-041
天水华天科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的
专项报告(2013年1-6月)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引,天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2013年1-6月募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1089号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准,公司于2013年10月以非公开的方式发行人民币普通股(A股)32,900,000股(每股面值1元),每股发行价格为人民币11.2元,募集资金总额为365,848,000.00元,扣除各项发行费用15,300,000.00元后,募集资金净额为人民币350,548,000.00元。该募集资金已于2013年10月21日全部到位,已经信永清华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信永验字[2013]第1703A173号《验资报告》。

2. 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位:万元

以前年度已投入	本报告期使用金额	累计利息	报告期末余额
金额	金额	收入净额	金额
35,201.55	0.01	-	149.76

截至2013年6月30日募集资金存款利息累计为149.76元。本报告期使用金额为公司募集资金专户收到已支付的利息0.01元。

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》,2011年11月4日公司与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

2013年1月7日,公司通过募集资金专户向西安公司增资13,300.00万元,用于其进行募集资金投资项目“集成电路高端封装测试产线技术改造”项目。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》,2011年11月4日公司与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

上述募集资金专户于2013年10月21日全部到位,已经信永清华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信永验字[2013]第1703A173号《验资报告》。

截至2013年6月30日,募集资金三方监管协议均得到了有效执行,不存在重大差异。截至2013年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存款金额	期初收入净额	已使用金额	存储余额
天水华天科技股份有限公司	交通银行股份有限公司天水支行	729030110018010012838	21,751.80	17.92	21,769.72	-
华天科技(西安)有限公司	昆仑银行股份有限公司西安分行营业部	7910200004880000338	13,300.00	131.84	13,431.84	-
	合计		35,051.80	149.76	35,201.56	-

三、2013年1-6月募集资金的实际使用情况
根据公司2010年12月22日召开的第三届董事会第六次会议、2011年2月15日召开的2011年第一次临时股东大会决议,本次募集资金用于“封装测试产线工艺升级技术改造”项目、“集成电路高端封装测试产线技术改造”项目和“集成电路封装测试产线工艺升级技术改造”项目。

截至2013年6月30日,公司募集资金的实际使用情况如下表:

项目	金额(元)	项目	金额(元)
募集资金总额	35,051.80	报告期末募集资金总额	0.01
募集资金使用总额	-	已累计投入募集资金总额	35,201.56

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因:募集资金使用总额大于募集资金总额,是由于募集资金专户收到已支付的利息0.01元。

募集资金使用总额与募集资金总额不一致的原因:募集资金使用总额大于募集资金总额,是由于募集资金专户收到已支付的利息0.01元。